

JT-3000T

3D锡膏厚度测试仪

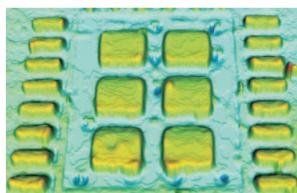
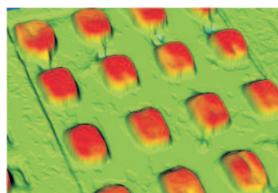
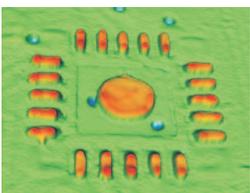
3D Solder Paste Inspection System

非接触式测量

自动SPC分析

完善品质管控

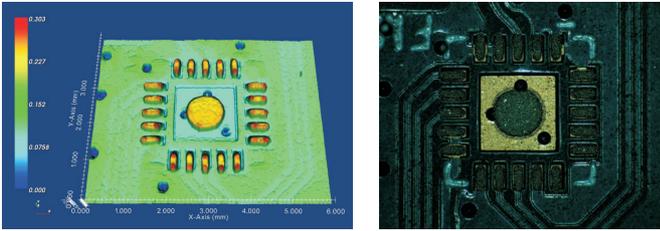
人性化操作UI



3D

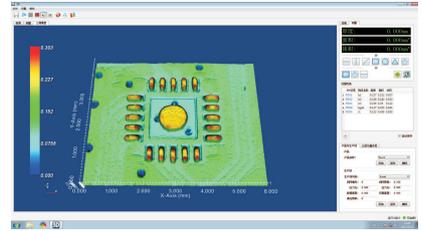
强大的3D图像处理及分析

采用美国军用3D图像处理技术,图像更细腻,逼真,方便分析出锡膏印刷问题.



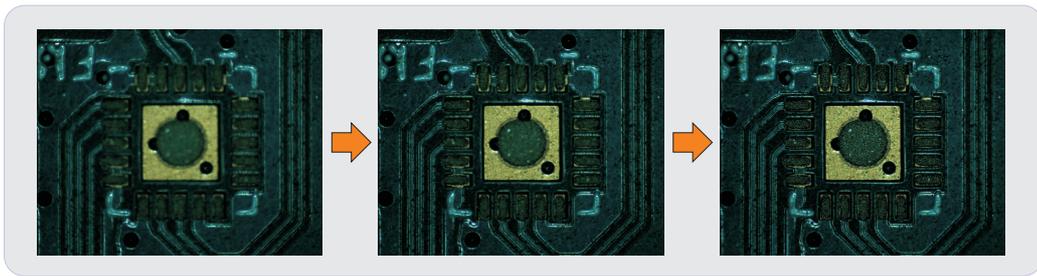
人性化UI、操作编程简单

大视野显示,简洁、人性化UI,编程方便快捷,一键式全自动扫描、SPC分析。



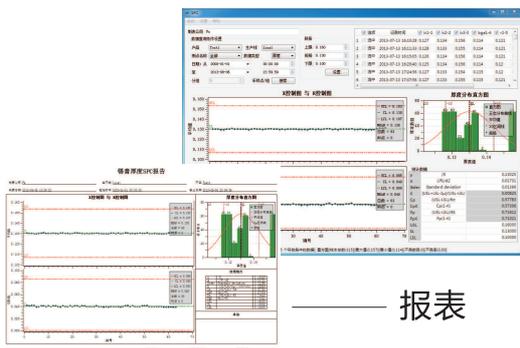
强大自动对焦功能,克服(FPC)板弯问题

系统会自动对焦到清楚后才扫描,以克服板弯(包括FPC)对测量结果的影响



全面的SPC分析功能,自动生成报表

测量数据自动记录后,可按设定时间、产线进行分析,生成X-Bar、R-Chart、直方图等,计算出Cpk、Cp、Pp等等制程指标;



夹具自动夹PCB功能

操作员只需要将PCB放到夹具上,按启动键,夹具会自动夹具紧PCB进行扫描



PCB夹具

技术参数

型号规格： JT-3000T

测试原理： 非接触式, 激光束

测量光源： 650nm红色激光线

测量精度： 0.001mm

重复精度： $\pm 0.002\text{mm}$

测量高度： 0-1000 μm

视野FOV： 6.0mmx4.8mm (分辨率1280*1024)

最大PCB尺寸： 400mmX300mm

扫描速度： 100fps, 间距分5、10、15 μm 三档

运动速度： 0-120mm/s, 自动夹PCB板

对焦方式： 自动对焦, 克服板弯问题

PCB平面修正： 三点参照修正倾斜和扭曲

测量结果： 厚度、面积、体积, 可导出Excel档

3D模式： 任意角度旋转、缩放, XYZ三维刻度

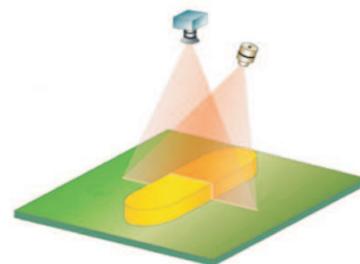
操作系统： Windows XP/Windows 7

外形尺寸： 800mm(L) X650mm(W) X460mm(H)

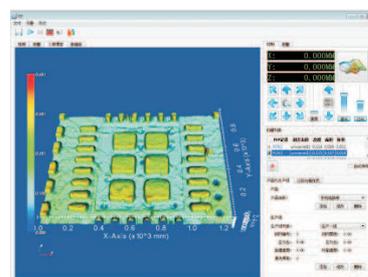
重量： 70kg

电源： AC100-240V 50/60Hz

测量原理



操作界面



应用领域

- 锡膏厚度测量
- 精密工件厚度测量
- 工件平面度
- PCB焊盘丝印等尺寸测量

外形尺寸

